

- 專為微機電(MEMS)產品設計，實現客戶在晶片級封裝(CSP)的先進封裝製程進行晶圓級的最終測試，簡化生產製造流程，讓客戶的測試成本降到最低。
- 提供MEMS測試全面性的產品，包括晶圓探針測試，多種激勵方式和封裝選項的測試機以及三溫測試。
- 使用Ring Frame方式進行測試，有別於傳統Pick & Place，可避免元件損傷，提高生產效率。

KRONOS

慣性感測器晶圓探針系統

- 可用於以下產品最終測試和校正
 - ✓ 加速度計
 - ✓ 磁力計
 - ✓ 陀螺儀
 - ✓ 電子指南針



AIOLOS

壓力感測器測試系統

- 可用於以下產品最終測試和校正
 - 壓力和真空偵測傳感器
 - 氣體和濕度偵測傳感器
- 需要真空及其他大氣環境下進行特徵測試的電子器件



MPP

集成多軸磁場仿真性能的多功能針測機

- 可用於以下產品最終測試和校正
 - 磁力計及其他半導體電子器件

